



東レAパレルCADシステム

クレアコンポⅡご紹介セミナー 開催のお知らせ

開催日程 2016年2月23日、24日

1回目 10:00～ 2回目 16:00～

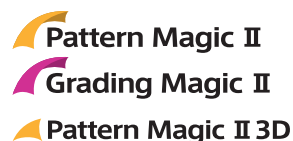
90分程度、各回60名様

開催場所 ムトーホール（武藤工業ビル1階）東京都世田谷区池尻3-1-3

東急田園都市線『池尻大橋』駅西口直結

主なメニュー

- ・新しい運用形態で、もっと便利にCADを活用しましょう。
- ・パターンメイキング、グレーディングの進化のポイント
- ・3Dシミュレーションの簡単な流れのご紹介。



詳細ご紹介コーナー

- ・パターンメイキング、グレーディング、詳細デモ
- ・体験機もご用意 ・その他、周辺機器の参考出展等

* 同日開催【XIFORM MAGICご紹介セミナー】

・別途お申込みください。申込み用紙を準備しています。

お申し込み書

* 参加をご希望される方は、以下に、必要事項をご記入の上、FAXにてご連絡ください。FAX 03-6327-7009

* 参加ご希望の回、もしくは資料請求(不参加の場合のみ)を、○で囲んでください。

* お申し込みご確認の連絡をいたしますので、ご記入漏れの無いよう、お願い致します。

* 参加費は、無料です。

* 複数でのお申込み受け付けます。皆様のお名前をご記入ください。

尚、誠に恐れ入りますが、お申込みは2月15日18:00で締め切りいたします。お早目にお申込みください。

お申込み後、3営業日経過しても弊社からの確認連絡がない場合は、お問合せください。

会社名			
住所			
電話番号 (必須)		FAX (必須)	
参加希望回 又は資料請求	2月23日 2月24日	1回目(10:00～) 1回目(10:00～)	2回目(16:00～) 2回目(16:00～) 資料請求(パンフレット送付)
参加者氏名	複数お申込みの際の代表者名は先頭にご記入ください。		